



報道発表

2010年4月14日

報道関係者各位

eBeam Initiative のメンバー会社が Photomask Japan 2010 で協業の成果を発表

新たに3社が eBeam Initiative に参加

(米国 San Jose 発) 設計から製造への革新的アプローチである design for e-beam (以下 DFEB)を普及、促進することを目標としたフォーラム eBeam Initiative は、本日、最先端リソグラフィーマスク技術の世界最高シンポジウムのひとつである Photomask Japan 2010 において、イニシアチブメンバー共同で、DFEB マスク・テクノロジーの最近の画期的な技術成果について発表いたします。この共同発表は、22 ナノメータ・ノード以降の先端ロジックデバイスの製造をサポートする DFEB マスク・テクノロジーの進化とその効果を指し示すものです。Photomask Japan 2010 は、パシフィコ横浜で4月13日 - 15日の期間で開催されます。

さらに、eBeam Initiative は3つの会社が新たに参加したことを発表いたしました。これらの3社—Advanced Mask Technology Center (GLOBALFOUNDRIES とトッパンフォトマスクのジョイントベンチャー) (以下 AMTC)、Fraunhofer CNT、および HOYA 株式会社—は、イニシアチブにとって DFEB マスク・テクノロジーの商業化をサポートする上で非常に重要エコシステム (関連技術・事業) を強化するためのキーとなる企業です。

Dr. Jan Hendrik Peters 氏 (AMTC R&D シニアマネージャ)

「DFEB マスク・テクノロジーを実適用する上で他の eBeam Initiative のメンバーと協力するのを楽しみにしています。DFEB マスク・テクノロジーを用いることにより、業界における非常に重要なビジネス的、および技術的課題に取り組むことができます。そしてこれは 193nm i 線にも EUV リソグラフィにも適用できます。私たちは、eBeam Initiative のメンバーとして光学リソグラフィを 22nm ノード以降に延命させる技術的手段の開発に協力できることを誇りに思います。」

eBeam Initiative のメンバーである JEOL と D2S は共同で、Photomask Japan 2010 の4月15日 午前 10:30-10:50、"Mask-related Lithography"セッションにおいて、"Best Depth of Focus on 22-nm Logic Wafers with Less Shot Count"という題名で論文発表いたします。さらに、イニシアチブのメンバーである JEOL、Petersen Advanced Lithography と D2S は共同で4月15日 午前 11:10-11:30、EDA, DFM and MDP セッションにおいて、"Writing 'Wavy Metal 1 Shapes on 22-nm Logic Wafers with Less Shot Count"という題名で論文発表いたします。どちらの論文も今回初めて発表されるもので、従来の手法と比較してより少ないショット数と短い描画時間で先端マスクを製造する上で、

DFEB マスク・テクノロジーを導入することに成功した例です。これは、光学リソグラフィを実践的な手法で 22nm ロジックノードに拡張できる可能性を示すものです。

Aki Fujimura (D2S CEO 及び eBeam Initiative の事務局長)

「今回、eBeam Initiative メンバー各社の協力によって、DFEB マスク・テクノロジーが実用可能な技術であることを明確に示す結果を得ることができました。また、今回新たに参加した企業の高度な専門知識を組み合わせることによって、イニシアティブの牽引力がますます強化されることは大変喜ばしいことです。そして、今後の各社の協力と貢献により、DFEB マスク・テクノロジーのロードマップをさらに進展させられることを期待しています。」

eBeam Initiative について

eBeam Initiative は、design for e-beam (DFEB)として知られる革新的な設計から製造へのアプローチを普及、促進することを目標としたフォーラムです。DFEB は、設計、設計ソフトウェア、製造、製造装置、および製造ソフトウェアの専門技術を組み合わせ、半導体のマスク費用を削減します。このイニシアティブのゴールは、IC の設計数を増やし、タイムトゥマーケットを短縮し、業界における DFEB 採用の障壁を減らすと同時に、半導体業界全体への投資を拡大することです。本イニシアティブは、メンバー企業、アドバイザー、およびステアリング委員会から構成されており、半導体関連の全分野の機関が参加しており、株式会社アドバンテスト、台湾 Alchip Technologies、米 Altos Design Automation、独 AMTC、米ケイデンス・デザイン・システムズ、仏 CEA/Leti、米 D2S 社、大日本印刷株式会社、Martin M. Deneroff 氏、株式会社イー・シャトル、米 eSilicon Corporation 社の Jack Harding 氏、米 Fastrack Design 社、独 Fraunhofer CNT、富士通セミコンダクター株式会社、独 GenISys GmbH 社、米グローバルファンドリーズ社、HOYA 株式会社、日本電子株式会社 (JEOL)、米 KLA-Tencor 社、米マグマ・デザイン・オートメーション社、株式会社ニューフレアテクノロジー、米 Petersen Advanced Lithography 社、米 PMC-Sierra 社の Colin Harris 氏、米クアルコム社の Riko Radojcic 氏、韓国サムスン・エレクトロニクス社、仏 STMicroelectronics 社、米 Tela Innovations 社、凸版印刷株式会社、米 Virage Logic 社、独 Vistec Electron Beam Lithography Group が含まれます。また、本イニシアティブは、エレクトロニクス業界におけるあらゆる企業および機関に対し、幅広く参加を募っています。URL : www.ebeam.org.

本件に関するご連絡先 :

株式会社 D2S

河内一往

Tel: 045-479-8390

E-mail: kazu@design2silicon.com

D2S Inc.

James Fong

Tel: +1-408-781-9017

E-mail: jfong@design2silicon.com

MCA

Angie Kellen

Tel: +1-650-968-8900, ext. 120

E-mail: akellen@mcapr.com

本報道発表内で提供されている情報は、発表日現在のもので、その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。